

# 國立高雄科技大學

## 「半導體封裝測試產業學分學程」規劃書

### 一、學分學程中文名稱

半導體封裝測試產業學分學程

### 二、學分學程英文名稱

Semiconductor Packaging and Testing Industry Credit Program

### 三、規劃設置單位

電機與資訊學院

### 四、參與學術單位

電子工程系(建工校區)、半導體工程系、電子工程系(第一校區)、電機工程系、電腦與通訊工程系、資訊工程系。

### 五、設置宗旨

台灣 IC 封裝與測試產業，穩坐全球之冠，隨著 IoT 應用、5G 通訊技術興起，台灣 IC 封裝與測試業者持續布局高階封裝與異質整合技術，以拉大與競爭業者之差距，所以必須持續培育優質的 IC 封裝與測試人才。因此，本校電機與資訊學院規劃半導體封裝測試技術能力培養課程，以提升本院電子、電機、資工、微電子、電通、電訊系之實務技術能力，為台灣產業厚植半導體封裝測試相關技術人才。

### 六、實施學制

日間部大學部

### 七、課程規劃及修讀相關規定

- (一) 凡國立高雄科技大學(以下簡稱本校)大學部學生，皆可修讀半導體封裝測試產業學分學程，所開設之課程，且應於每學期加退選期間內辦理之。
- (二) 招收名額以本校選課須知所規定之選修人數為限制。
- (三) 跨領域學程最低修習學分總數至少 20 學分，各學程選修科目如下表所列。
- (四) 學生修習本學程之學分依各系規定併入畢業最低總學分數內，且受每學期修習學分上限之規定。
- (五) 學生修畢滿足本學程學分規定之課程且成績及格者，得向綜合業務處申請本產業學分學程證書。
- (六) 本辦法未規定之事宜，悉依本校學則及相關法令之規定辦理。
- (七) 本辦法經電機與資訊學院課程委員會會議通過後，提送校課程委員會審核通過後實施，修正時亦同。

課程類別	課程名稱
基礎課程 (任選 6 學分以上)	半導體封裝跨領域學程基礎課程 半導體測試跨領域學程基礎課程
進階課程 (任選 6 學分以上)	半導體封裝跨領域學程進階課程 半導體測試跨領域學程進階課程
專業課程 (任選 6 學分以上)	半導體封裝跨領域學程專業課程 半導體測試跨領域學程專業課程
實習學分 (任選 2 學分以上)	暑期實習 (2 學分) 學期實習(一) (10 學分) 學期實習(二) (10 學分) ※必須完成校外相關職場實習至少 320 小時(2 個月)，或 需於本校半導體封裝測試中心完成至少 320 小時的專案 實習。

※此學程選讀可不用跨系選修。

學程審查	規劃設置單位核章
108 年 10 月 22 日 院級課程會議通過 108 年 11 月 27 日 校課程會議通過 108 年 12 月 11 日 教務會議通過	